CCAF-05Aluminum-base copper-clad laminate

The test base：

Thickness of the copper：18um, 35um, 70um

Thickness of the diclectric：80um（matrial of the high heat dissipation）

Thickness of the aluminum-base：0.8, 1.0mm, 1.5mm， 2.0mm

The result of the test：

Item	Test item		Technology request	Unit	Test result
1	Peel Strength	A	≥1.0	N/mm	1.08
		After thermal stress（260℃）	≥1.0	N/mm	1.05
2	Blister test AfterThermal stress（288℃, 2min）		288℃ 2 min No delaminating	/	OK
3	thermal resistance		≤2.0	℃/W	0.45
4	Thermal Conductivity			W/m·k	2.2
5	Flammability(A)		FV-O	/	FV-O
6	Surface Resistivity	A	≥1×10^5	MΩ	3.68X10^7
		Constant humidity treatment (90%,35℃,96h)	≥1×10^5	MΩ	3.39×10^6
7	Volume Resistivity	A	≥1×10^6	MΩ·m	4.2×10^8
		Constant humidity treatment (90%,35℃,96h)	≥1×10^6	MΩ·m	3.17×10^6
8	Dielectric Breakdown		≥2	Kv	4.8
9	Dielectric constant（1MHz）（40℃，93%，96h）		≤4.4	/	4.24
10	Dielectric dissipation factor（1MHz）（40℃，93%，96h）		≤0.035	/	0.033